

PHT

Link To The World

PHT株式会社(英文名:PHT Inc.)

邮编115-0045, 日本东京都北区赤羽2-69-2千秀大厦6楼

TEL:03-6751-7153 FAX:03-6761-8935

E-Mail:info@pht.co.jp

<https://www.pht.co.jp>

晶圆搬运系统

PWT2020



产品概要

该系统应用于300mm的晶圆传送,可对应FOUP、FOSB、OPEN、PFA等不同晶圆片盒。标准单片式搬运,也可以选配同时搬运5片或25片。支持晶圆盒之间的安全批量搬运或Slot指定搬运(也可在同一容器内搬运)。该系统特点为接触点最小化、防止磨损、防止污染产生以及防止晶圆边缘损坏等功能。

另外也包含晶圆未对准和堆叠、防撞功能。并且配备误操作防止传感器和紧急停止按钮等。

设备规格

工作对象

半导体基板

尺寸

300 mm

厚度

600 ~ 850 μ m

电源供应

AC200V, 15A

晶圆盒(容器)

FOUP·FOSB·OPEN·PFA

产量

25片/盒传送时间 300秒以下

驱动系统

电机驱动(伺服)

设备重量

约500 kg

设备尺寸

W1000 × D1400 × H1800 (mm)

运输单元

1片·5片·25片

安全机制

晶圆盒有无、晶圆有无、过载检测、异常报警、紧急停止

选项

静电消除器(离子发生器)、全罩、区域传感器、ID 读取器、对准、晶圆反转等

产品特点

- 节省空间
- 防静电型
- 使用光电和机械传感器监控误操作
- 配备测绘传感器
- 兼容FOUP、金属片盒等
- 可应用在Class 10级无尘室

应用案例

1. 设备厂商使用案例

- ① 测试晶圆由芯片制造商以FOSB (装运箱) 形式提供
- ② 转移到设备制造商系统使用的片盒 (如FOUP)
- ③ 将测试后的晶圆转移到FOSB (返回芯片制造商处)

设备制造商示例

刻蚀机·清洗机·涂胶显影设备·曝光机等

2. 晶圆厂商使用案例

- ① 将完成的晶圆 (在最终清洁/检查完成后) 转移到FOSB (出货容器)
- ② 在工序间 (清洗工序等) 转移到PFA容器上